



RE933-04

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestita con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per TSSOP 20
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Diametro del foro 1,00 mm
- Dimensioni 15,88 x 23,50 mm

N. modulo	Pitch	mil	Pin	Dimensioni (mm)
RE933-04	0,650 mm	22,5	20	4,400 (173 mil)